

BST-21503A 150g Pâte à souder de qualité supérieure pour LED BGA SMD PGA Top Vente Pâte à souder Flux Grease

Description du produit:

100% neuf et de haute qualité !!

Le flux de colophane est utilisé pour faciliter le soudage.

Il nettoie et prévient l'oxydation des métaux, ce qui permet à la soudure de créer des liaisons mécaniques et électriques solides et durables.

Il agit également comme un agent mouillant, augmentant le flux de soudure et l'efficacité du processus de soudage.

Parfait pour les téléphones mobiles, les cartes PC et autres soudures sophistiquées au niveau du chip.

Caractéristiques:

Produit: BST-21503A

Point de fusion: 60 °C

Poids: 150 g / pc

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT DETAILS



Name: Soldering Paste

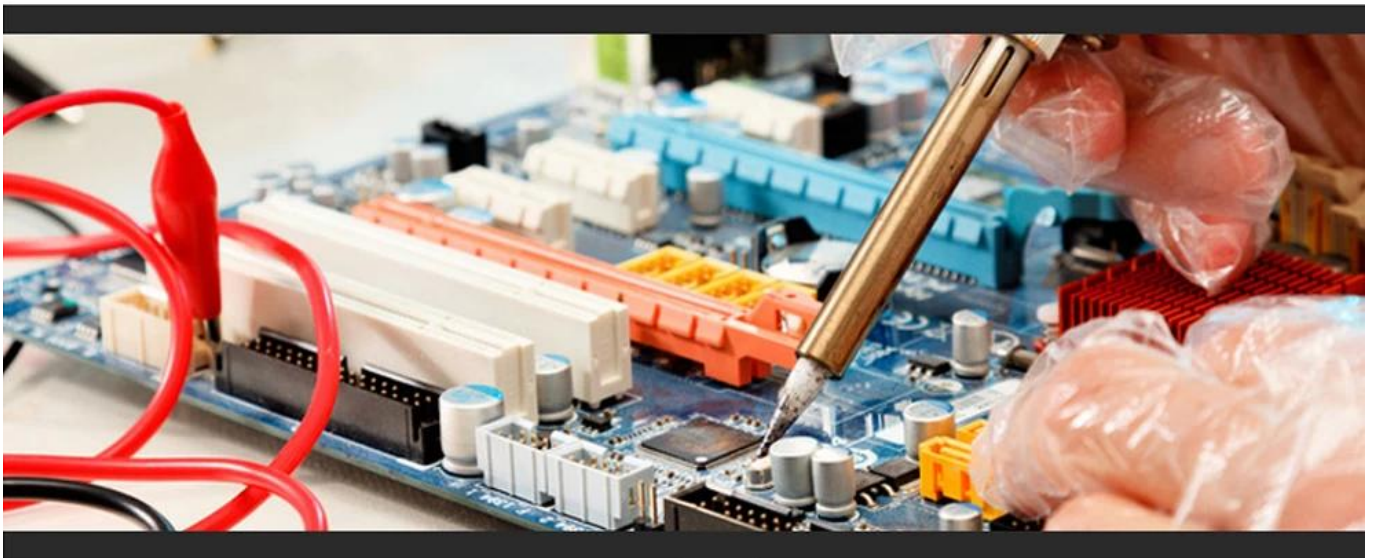
Size: $\Phi 80 \times 45$ mm

Composition: Solder powder, resin

Model: BST-21503A

Weight: 100g

Melting point: 60°C





- ▲ Stable performance, Not volatile, long life cycle, the amount of province;
- ▲ Non-toxic non-irritating odor, the use of safe and reliable;
- ▲ The IC and PCB are not corrosive
- ▲ Its boiling point is only slightly higher than the melting point of solder.

Features: Solder melting at the time of soldering begins to boil endothermic vaporization, which can be maintained at this temperature using IC and PCB temperatures. In the demolition of the chip with a lot of solder paste, it melts fast, you can flow to the BGA chip below. Rosin is solid without solder paste convenient.

PRODUCT PHOTOGRAPH



